

2005年9月7日



株式会社豊通エレクトロニクス

## **豊通エレクトロニクスとキャッツ(株)が、国内デファクトCASEツール「ZIPC」の海外販売展開で協力関係を発表**

株式会社豊通エレクトロニクス(社長・松平惣一郎、愛知県名古屋市)は、キャッツ株式会社(社長・上島康男、横浜市港北区)と、主力製品である、組込みシステム開発支援CASEツール「ZIPC」の海外への販売展開、自動車及び電装品メーカー向け販売を目的に、代理店販売契約の締結を前提とした協力関係を構築することを発表した。

キャッツ株式会社(1973年設立)は、JASPARの正会員として参画しており、1990年に発表した「ZIPC」は、国産初のCASEツールとして、デジタル家電や携帯電話、制御システムなどの開発ツールとしての評価を高め、組込みシステム開発用CASEツール分野で1998年以来7年連続の国内シェア首位(電子情報技術産業協会(JEITA)調べ)を続けている。

ZIPCの特長は、プログラムの「事象」「状態」「処理」をモレヌケ無く設計することができる「拡張階層化状態遷移表(EHSTM: Extended Hierarchy State Transition Matrix)」を用いて、3次元的なモデリングからモデル・シミュレーション、コード自動生成等を行うことが可能ある。

近年の自動車における要求分析や設計では、従来からの自動車の機能である「走る・曲がる・止まる」だけでなく、安全性、確実性、環境対策、マルチメディア等の様々な機能を実現させるために、ECU(Electric Control Unit)と呼ばれる、機能毎に分かれる多くの部品から構成されており、それらの複雑な関係を制御する必要がある。

ZIPCは、このような複数ECU間の複雑な関係を合理的に、効率よく、分析・設計するのに適しており、国内外の自動車及び電装品メーカーにとって今後、必需品となるツールである。

『純国産のCASEツールであるZIPCを弊社海外ネットワーク、販売力を最大限に駆使し、世界へ展開することで、当社開発ツールビジネスの拡充を図っていく所存です。』

株式会社豊通エレクトロニクス  
代表取締役社長  
松平 惣一郎

『膨大化/複雑化する自動車開発において、開発の効率化、品質確保の鍵は「上流設計」にあると考えております。今回の協力関係は、ソフトウェア工学に裏付けされた有効的な技術と、それに基づいた開発環境、CASEツールをより広く、世界に向けて発信できることと確信しております。』

キャッツ株式会社  
代表取締役社長  
上島 康男氏

本件に関するお問合せ先

株式会社豊通エレクトロニクス  
ソフトウェアインテグレーショングループ 香野 Tel:052(584)8708